

平成 20 年 9 月 22 日
溶学研第 20-43 号

委員各位殿

社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 日置 進
(公印省略)

第 46 回ソルダリング分科会開催通知

第46回ソルダリング分科会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上ご出席下さいますようご案内申し上げます。出欠は10月17日(金)までにお知らせ下さい。

以 上

記

1. 日 時 平成 20 年 10 月 24 日(金) 10:30~16:30
2. 場 所 自動車会館 大会議室(2F) (案内図参照)
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番13号

◎分科会へ「登録2」の事業所から出席の場合、参加費として 10,000 円が必要です。

当日は請求書を発行いたしますので、後日、溶接学会へ送金して下さい。この会費で2名まで参加できます。

「登録1」の事業所では、既に年間参加費をお支払い戴いておりますので、2名まで参加できます。

◎一事業所から3名以上出席される場合には、3人目の方から参加費として、1名につき 5,000 円納入願いますのでご了承下さい。なお、その場合には予め出欠連絡用紙にてご連絡下さい。委員会当日請求書を発行させていただきますので、後日溶接学会に送金して下さい。

◎委員会にて発表される資料を募集しておりますので、発表して頂ける方は幹事(藤本)まで御連絡下さい。現場ニュース、研究ニュースのようなものでも結構です。

【出欠・事務関連の連絡先】

(社)溶接学会 事務局 木暮

E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp

TEL: 03-3253-0488 FAX: 03-3253-3059

【発表申込み先】

藤本(大阪大学)

E-mail: fujimoto@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

TEL: 06-6879-7550

【マイクロ接合研究委員会ホームページ】

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/index.html>

第46回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成20年 10月 24日(金) 10:30～16:30

場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区)

主 題 「Pb 含有高温はんだの代替技術」

	時 間	題 目	講 演 者
平成 20 年 10 月 24 日 金 曜 日	10:30～ 12:00	司会 出田 吾朗(三菱電機(株))	
		『パワー半導体デバイス用 高温はんだ接合と信頼性』 (45分)	CREST-JST、東北大学 ○高久佳和、大沼郁雄、石田清仁 (株)豊田中央研究所 山田靖、八木雄二 (株)トヨタ自動車 中川郁朗、渥美貴司
		『高温用鉛フリーはんだの接合特性』 (45分)	大阪大学 産業科学研究所 ○金権鉄、金声俊、姜玟、菅沼克昭
	12:00～ 13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～ 13:10	分 科 会 議 事	
	13:10～ 14:45	司会 藤内 伸一(日本アイ・ビー・エム(株))	
		【招待講演】 『宇宙分野における ソルダリング技術の取り組み』 (50分)	独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 ○根本規生 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 日本アビオニクス(株) ○中川 剛
		『酸化銀マイクロ粒子を用いた in-situ 銀ナノ粒子形成接合法』 (45分)	(株)日立製作所 材料研究所 ○守田俊章、保田雄亮、井出英一 大阪大学 廣瀬明夫
	14:45～ 15:00	休憩	
	15:00～ 16:30	司会 大森 弘治(松下電器産業(株))	
		『鉛フリー耐熱溶ダペーストの開発』 (45分)	(株)村田製作所 ○高岡英清、中野公介 千住金属工業(株) 上島 稔
		『Sn 基鉛フリーはんだのソルダリング特性に 及ぼす Ag,Ni,Ge 添加の影響』 (45分)	富士電機アドバンステクノロジー(株) ○山下満男、日高昇 群馬大学 荘司郁夫

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。